

2022年3月期 第1四半期（2021年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2021年8月16日

内容：

- 第1四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。

一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第1四半期 連結決算の概要

2021年8月16日

布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長



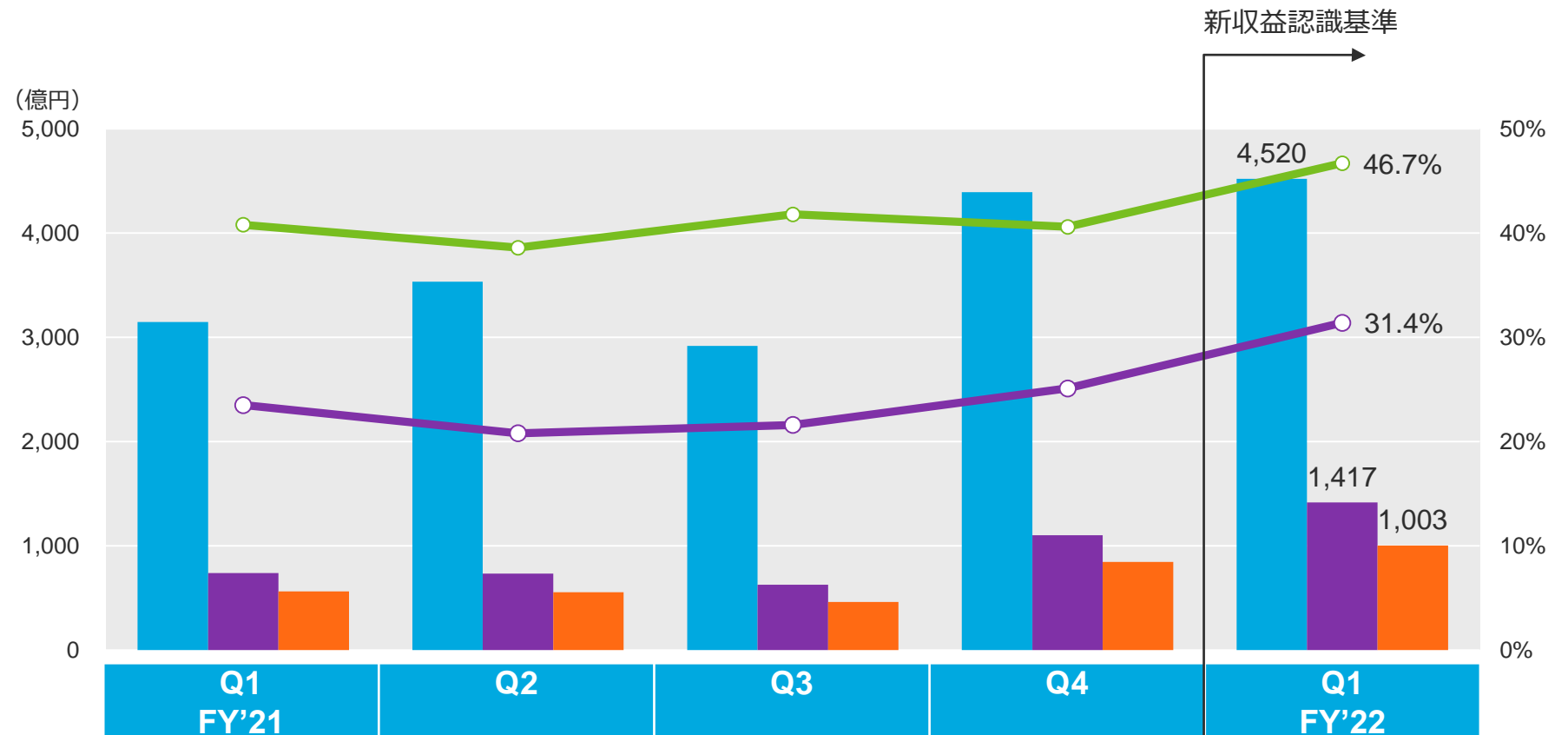
損益状況

新収益認識基準
(億円)

	FY2021				FY2022
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	3,148	3,533	2,917	4,392	4,520
SPE	3,037	3,316	2,643	4,154	4,379
FPD	110	216	273	237	140
売上総利益 下段：売上総利益率	1,284 40.8%	1,363 38.6%	1,219 41.8%	1,782 40.6%	2,109 46.7%
販管費	546	627	590	678	691
営業利益 下段：営業利益率	738 23.5%	735 20.8%	628 21.6%	1,103 25.1%	1,417 31.4%
税金等調整前当期純利益	746	730	623	1,069	1,380
親会社株主に帰属する 当期純利益	564	555	461	847	1,003
研究開発費	301	362	330	371	343
設備投資額	132	149	88	168	106
減価償却費	71	81	88	97	79

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

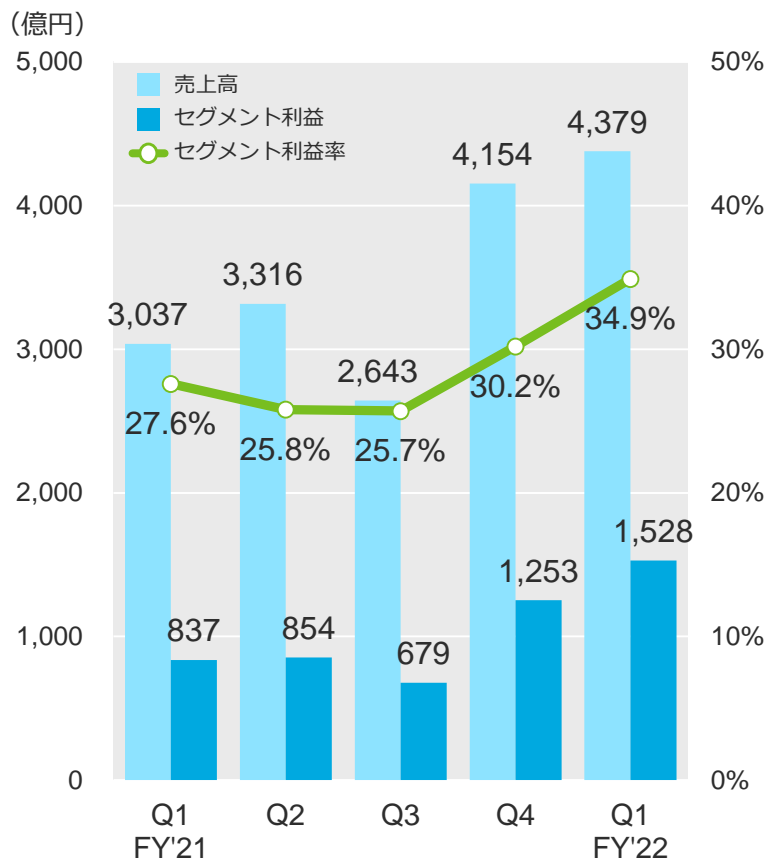
損益状況



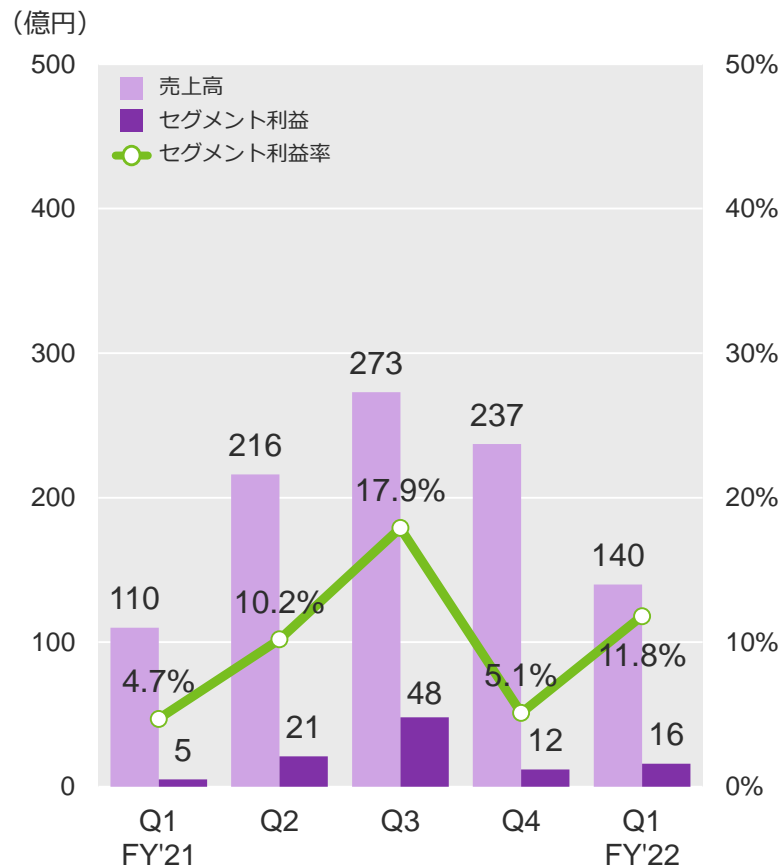
■ 売上高	3,148	3,533	2,917	4,392	4,520
■ 営業利益	738	735	628	1,103	1,417
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	564	555	461	847	1,003
○ 売上総利益率	40.8%	38.6%	41.8%	40.6%	46.7%
○ 営業利益率	23.5%	20.8%	21.6%	25.1%	31.4%

セグメント情報

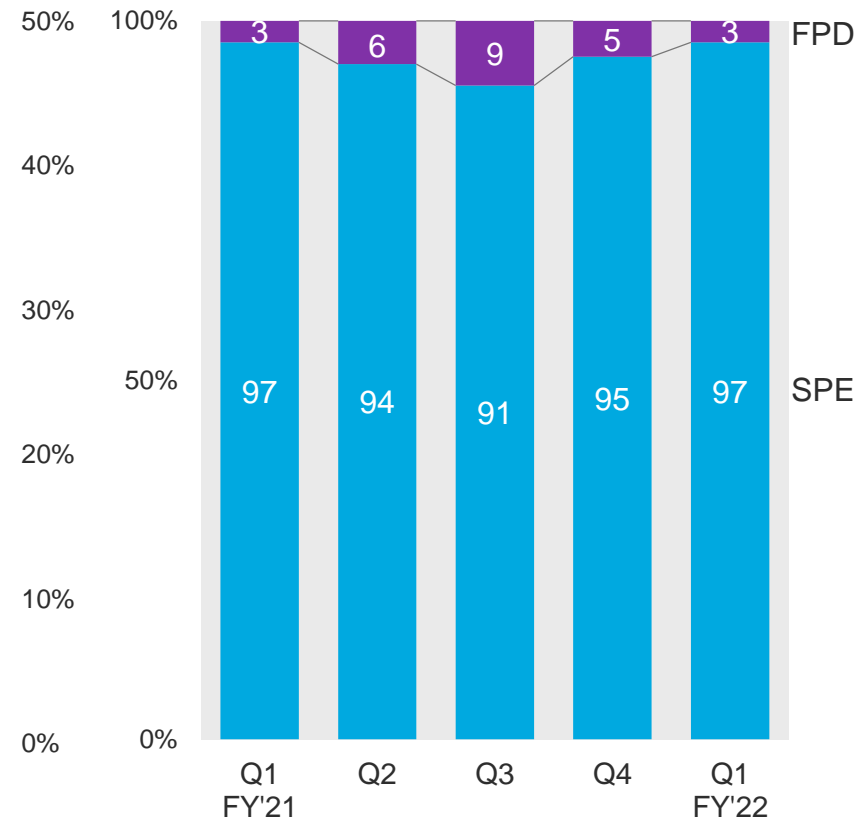
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

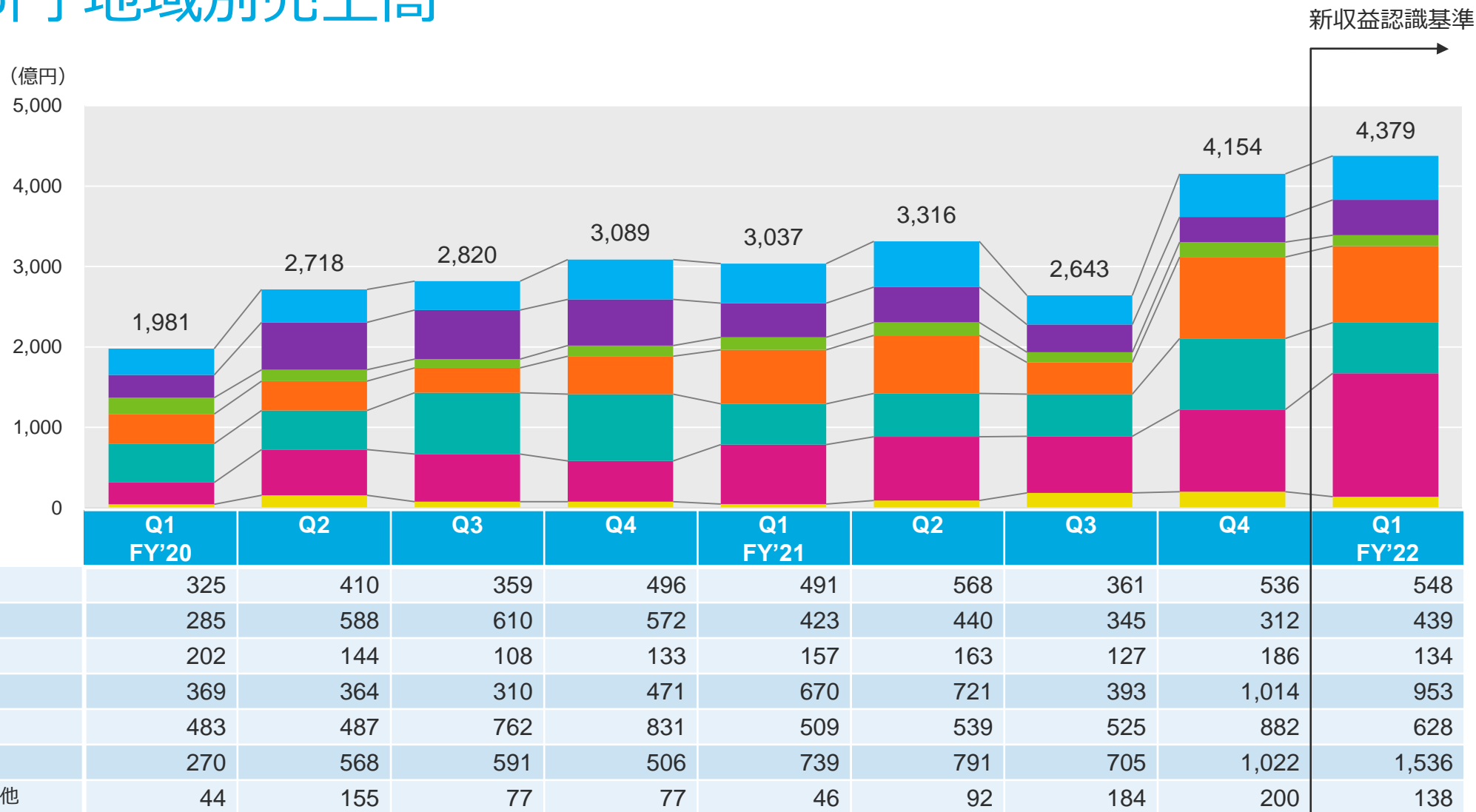


売上構成比率

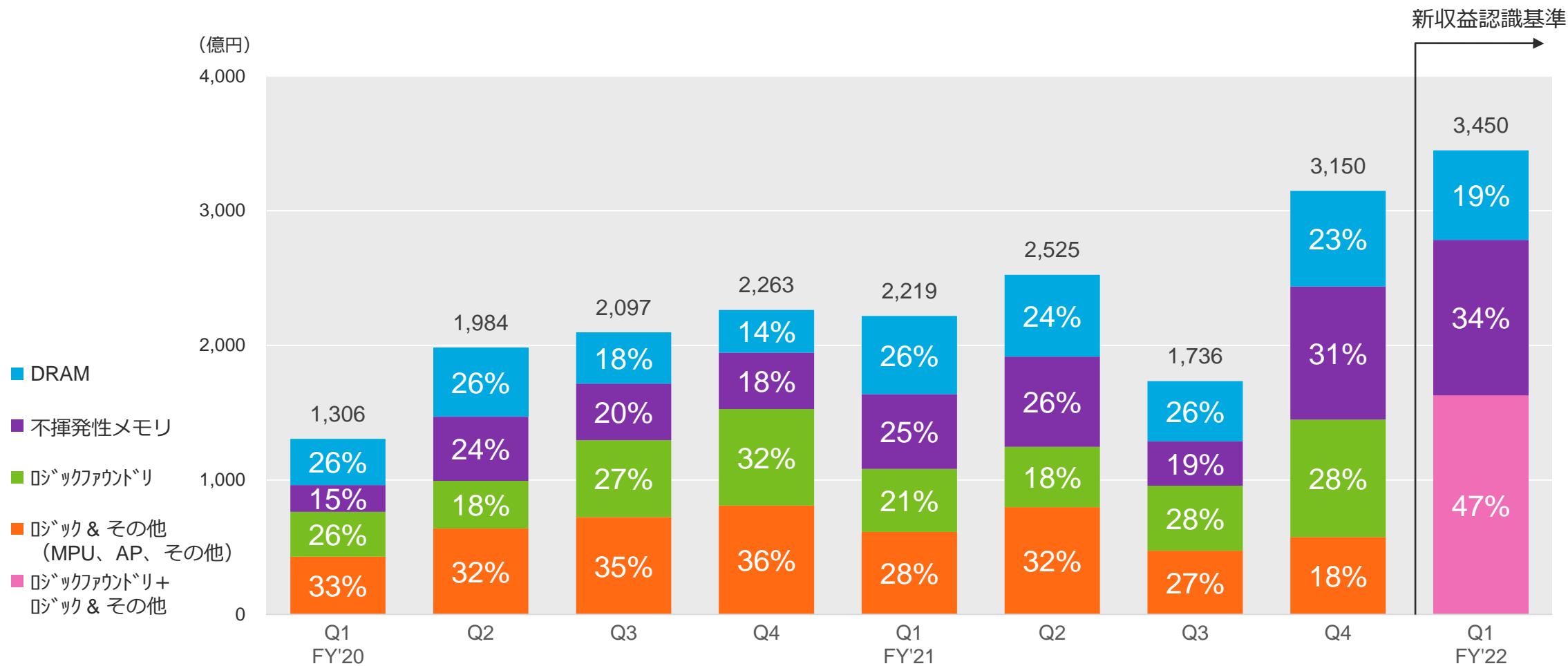


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

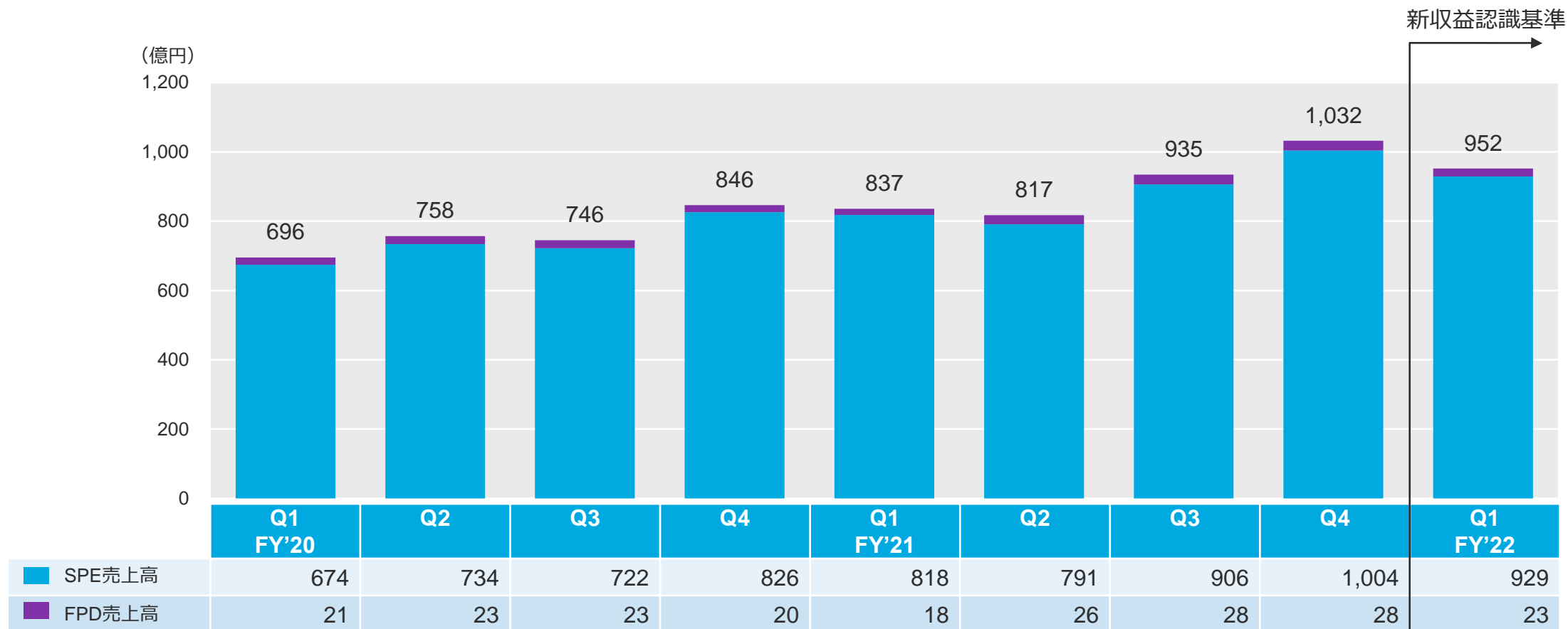
SPE部門 地域別売上高



SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



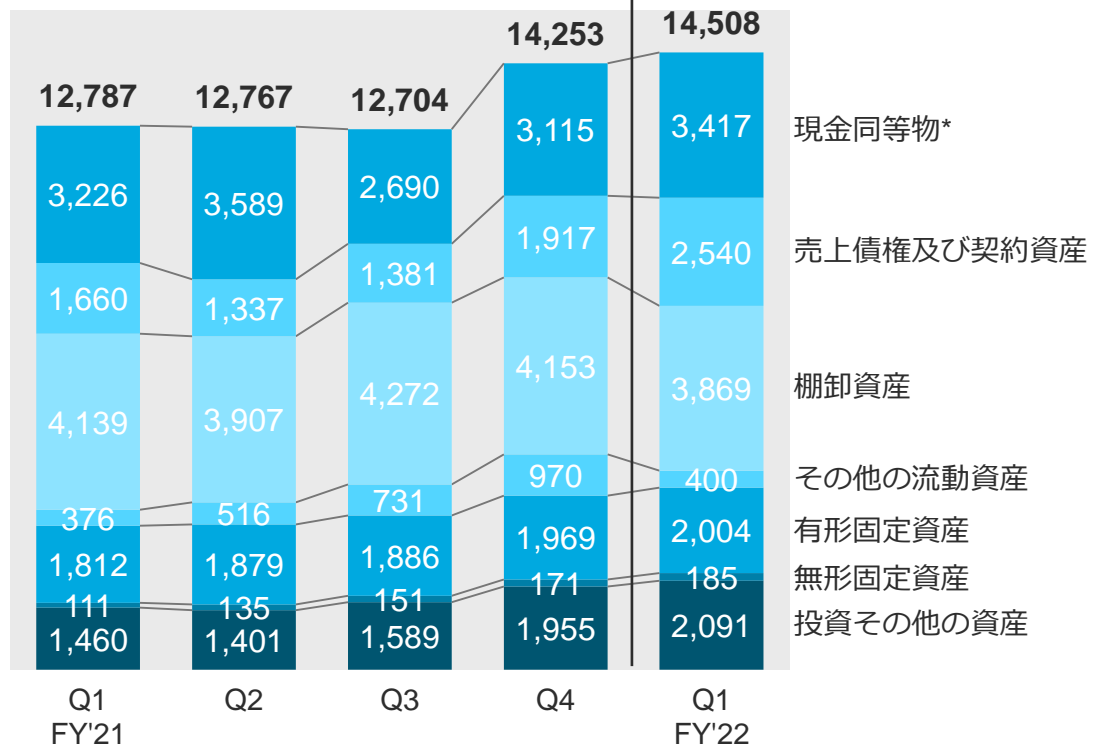
フィールドソリューション売上高



貸借対照表

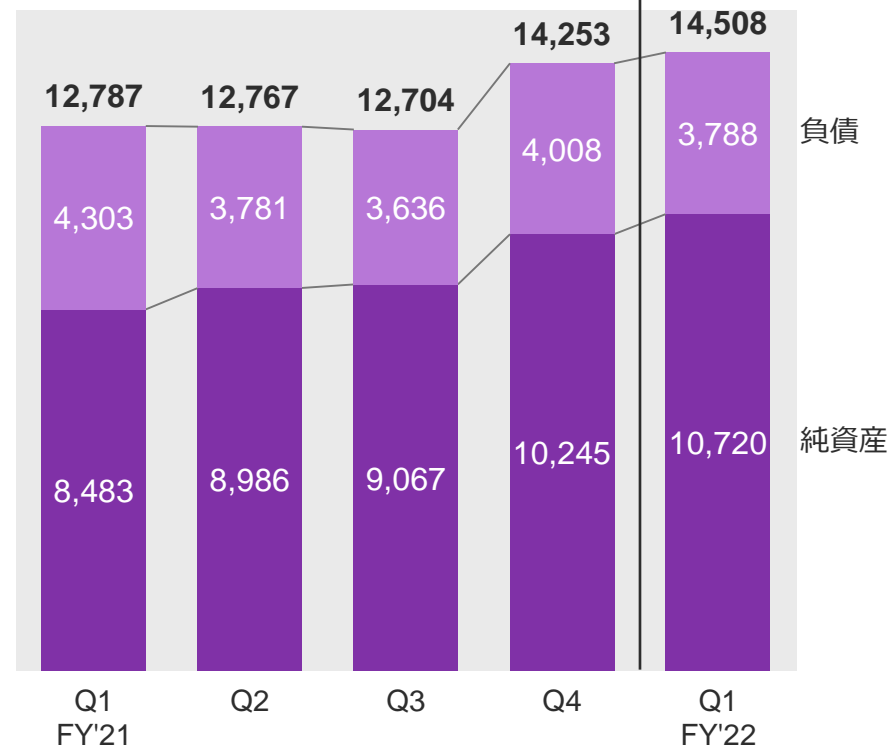
資産

(億円)



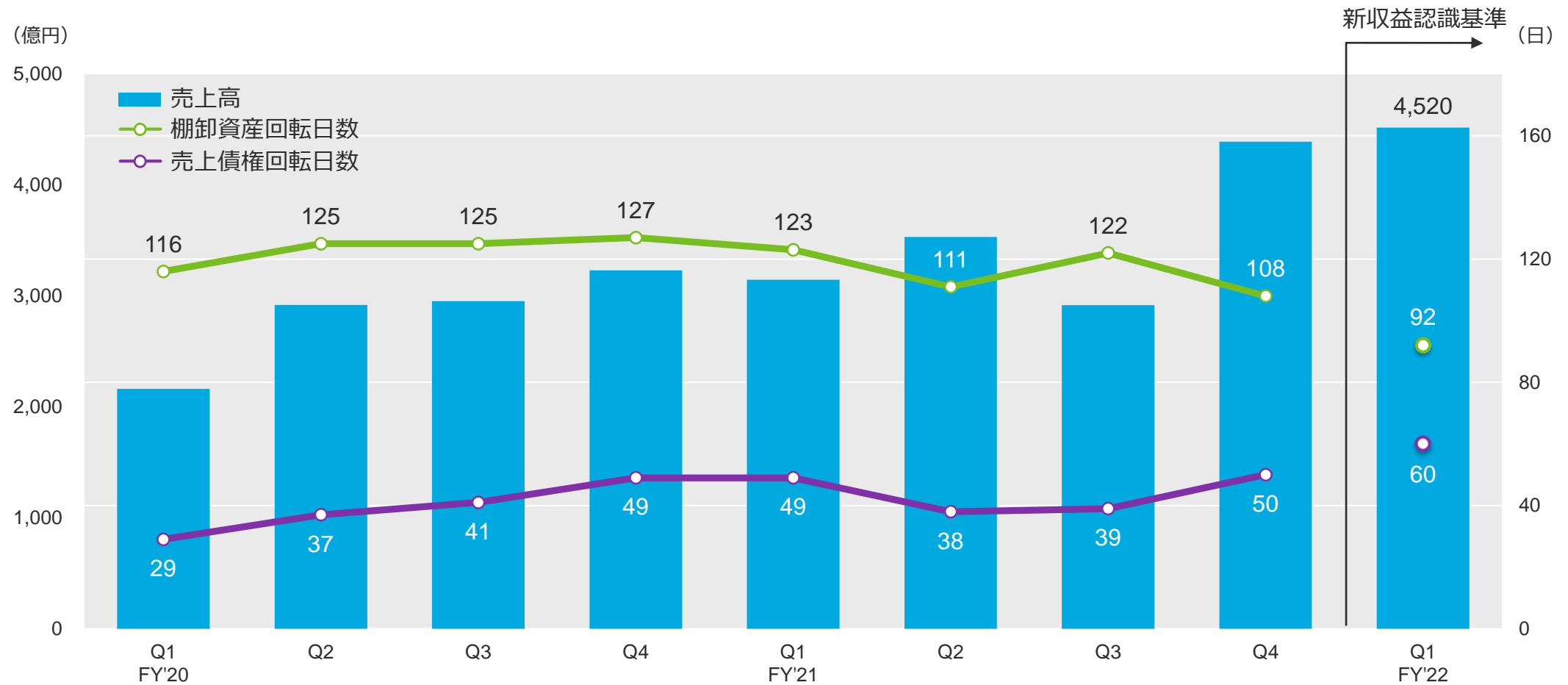
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

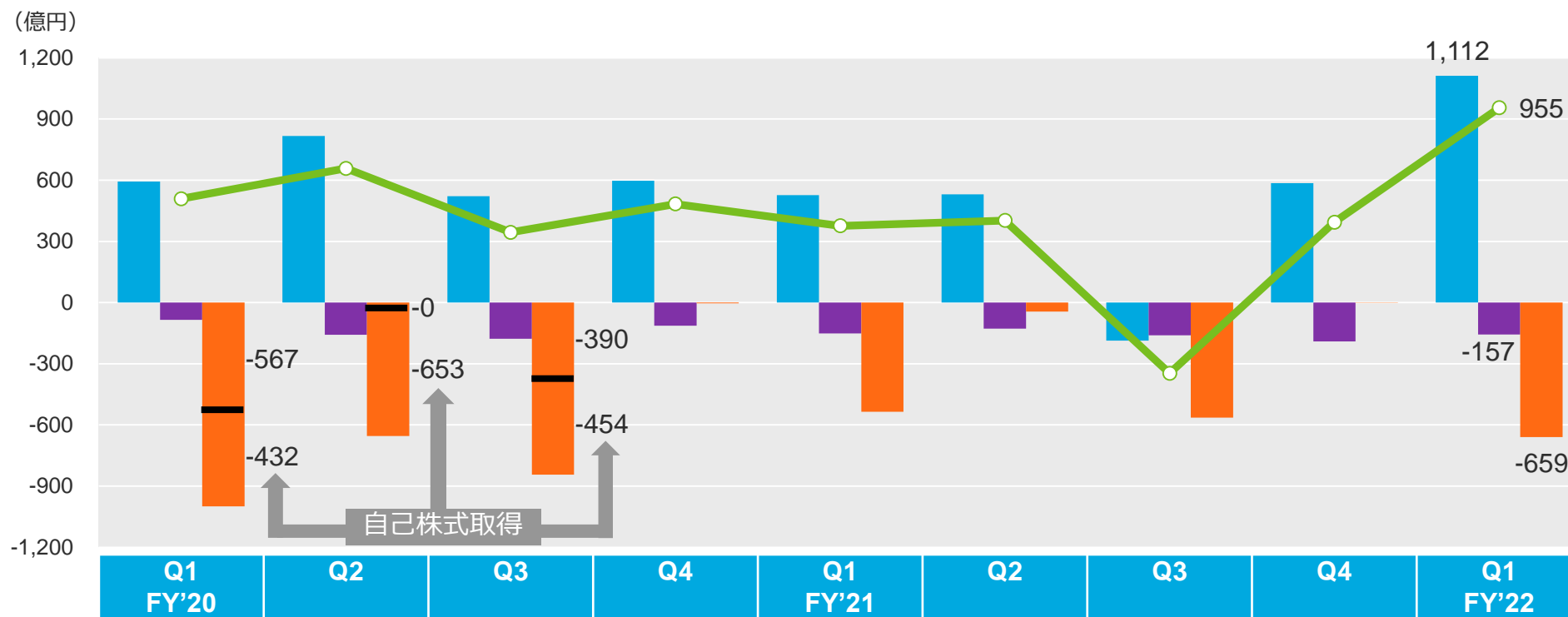
棚卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくは棚卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月間売上高 × 365
 (売上債権には契約資産を含みます)

FY'22Q1の回転日数については、過去3四半期においては旧収益認識基準、当四半期においては新収益認識基準に基づいた売上高にて算出しています。

キャッシュ・フロー



	Q1 FY'20	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'22
営業キャッシュ・フロー	594	817	521	597	527	531	-186	586	1,112
投資キャッシュ・フロー*1	-85	-158	-177	-114	-151	-128	-160	-191	-157
財務キャッシュ・フロー	-999	-654	-844	-4	-535	-44	-564	-1	-659
フリーキャッシュ・フロー*2	509	658	344	483	376	402	-347	394	955
手元資金残高*3	3,408	3,399	2,922	3,384	3,226	3,589	2,690	3,115	3,417

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

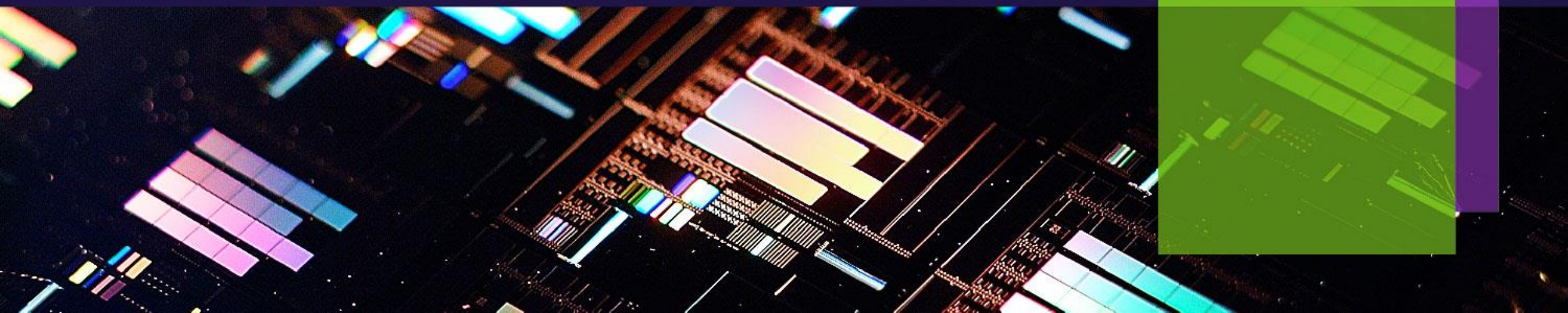
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2021年8月16日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



CY2021 事業環境（2021年8月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

データセンター投資のさらなる加速など、社会のデジタルシフトの進展による先端ロジックやメモリ需要の急増を背景に、WFE市場は大幅に拡大。
CY2021は前年比 4割程度の成長を見込む

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

モバイル向けOLED投資は前年比で増加も、大型パネル向けLCD投資は一巡。
今後、OLED投資に牽引され市場の成長が期待できるが、
CY2021は大型パネル向け投資がLCDからOLEDに移行する端境期として
前年比 2割程度の減少を見込む

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

CY2021 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比 45%程度増加
 - 市場環境：情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が一層進み、市場成長を牽引
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比 60%程度増加
 - 市場環境：5Gモバイル、PC、データセンターの需要の増加により需給が逼迫。高水準の投資を見込む
 - 事業機会：微細化に向けた新たな技術、新たな材料への対応
- 不揮発性メモリ：前年比 15%程度増加
 - 市場環境：中長期のビット需要成長に向け、着実な投資が継続
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2022 Q1 事業進捗

- 中期経営計画の達成に向け、着実に前進
 - 新規POR*獲得が進展
 - 旺盛な需要に対し各工場とも生産能力を増強。強固な生産体制で対応
 - 顧客工場の高い稼働率を背景に、フィールドソリューションも計画どおり順調に進捗
 - 環境への取り組み強化に向けたサプライチェーンイニシアティブ「E-COMPASS」を公表

* POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

FY2022 業績予想

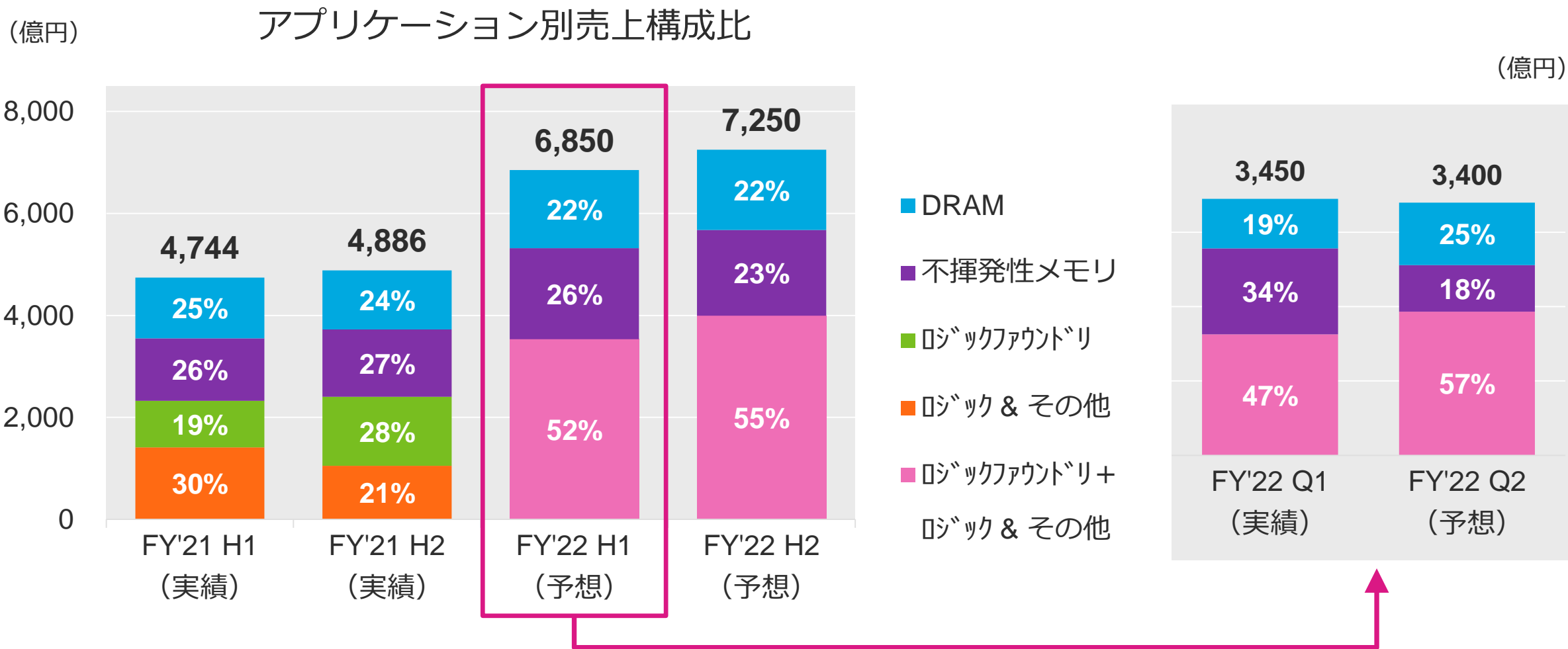
FY2022 業績予想

* 修正額：2021年4月30日に発表した業績予想からの修正額を示しています。
(億円)

	FY2021	FY2022					
	実績	新予想			修正額*		
	通期	H1	H2	通期	H1	H2	通期
売上高	13,991	9,000	9,500	18,500	+600	+900	+1,500
SPE	13,152	8,740	9,190	17,930	+600	+900	+1,500
FPD	837	260	310	570	0	0	0
売上総利益	5,649	4,000	4,240	8,240	+350	+500	+850
下段：売上総利益率	40.4%	44.4%	44.6%	44.5%	+0.9pts	+1.1pts	+1.0pts
販管費	2,442	1,550	1,610	3,160	+80	+110	+190
営業利益	3,206	2,450	2,630	5,080	+270	+390	+660
下段：営業利益率	22.9%	27.2%	27.7%	27.5%	+1.2pts	+1.7pts	+1.5pts
税金等調整前当期純利益	3,170	2,400	2,630	5,030	+220	+390	+610
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,429	1,750	1,950	3,700	+120	+280	+400
1株当たり当期純利益 (円)	1,562.20	1,124.99	-	2,378.53	+77.10	-	+257.04

さらなる需要増加を反映し、通期業績予想を上方修正

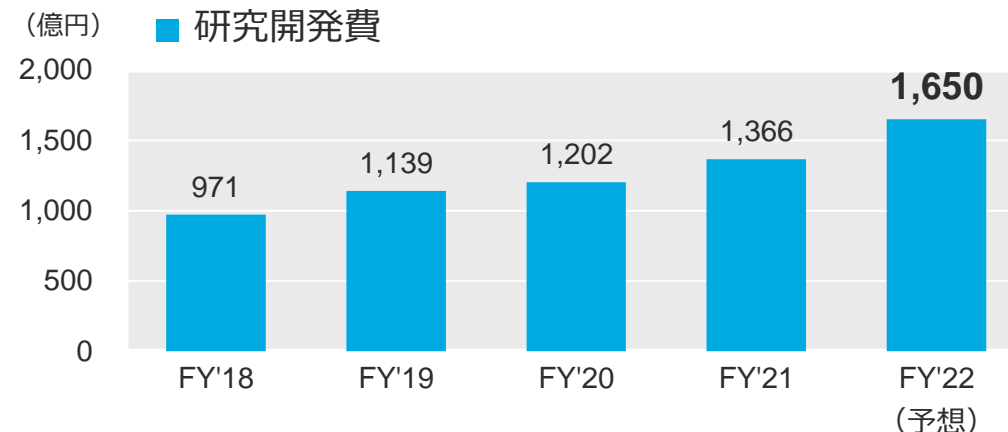
FY2022 SPE部門 新規装置売上予想



過去最高であったFY2021を大幅に上回る見込み

FY2022 研究開発費・設備投資計画

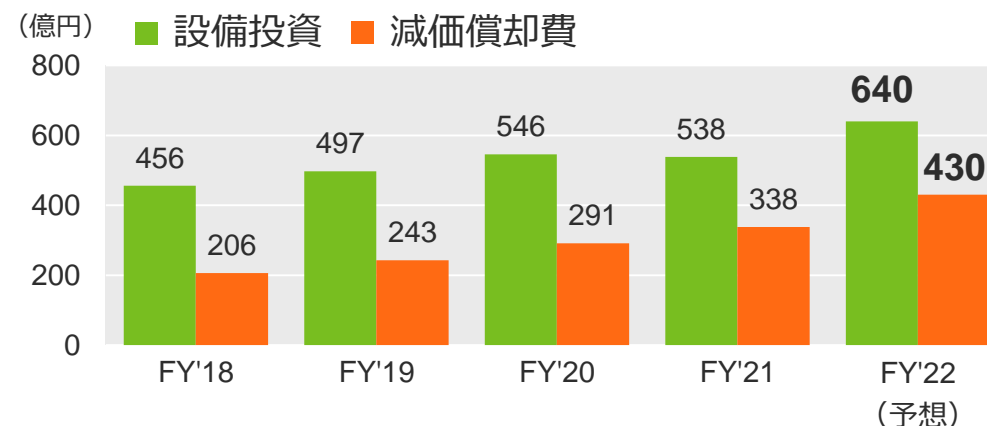
- 研究開発費 1,650億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 640億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 430億円



宮城県黒川郡：建設費約70億円
(2021年9月 竣工予定)



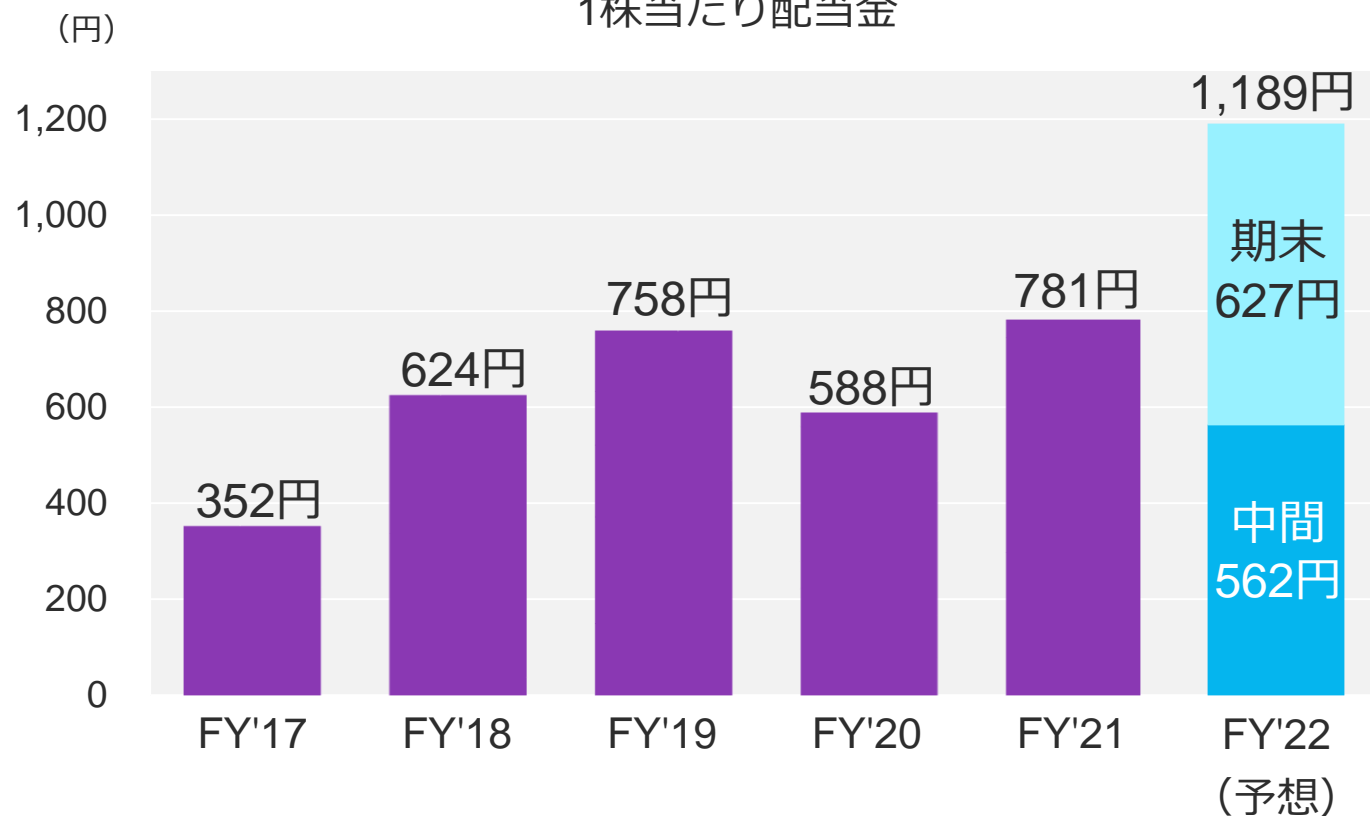
山梨県韮崎市：建設費約110億円
(2023年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、
研究開発、設備投資を加速

FY2022 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たりの配当金は、配当性向 50%に沿って1,189円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON